

2026年度第1四半期 決算補足説明資料

2026年8月6日



2026年度第1四半期業績

(単位：億円)

		2025年度		2026年度		前年同期比	
		第1四半期実績	利益率	第1四半期実績	利益率	増減額	増減率
売上高	電子回路基板	427		602		175	41.0%
	電子機器	104		130		26	25.0%
		531		732		201	38.0%
営業利益	電子回路基板	48	11.2%	56	9.3%	8	16.7%
	電子機器	8	7.7%	5	3.8%	-3	-37.5%
		56	10.5%	61	8.3%	5	8.7%
経常利益		49	9.2%	56	7.7%	7	14.2%
当期純利益		38	7.2%	40	5.5%	2	5.5%
期中平均為替レート (JPY/USD)		158.24		160.72		150	

2026年度第1四半期 商品別実績

(単位：億円)

		2025年度	2026年度	前年同期比	
		第1四半期実績	第1四半期実績	増減額	増減率
	車載	221	277	56	25.3%
	スマホ・タブレット	61	81	20	32.8%
	衛星通信	43	122	79	183.7%
	半導体PKG基板	4	4	0	0.0%
	モジュール基板	22	32	10	45.5%
	AIサーバー	14	26	12	85.7%
	アミューズメント、スマート家電、 産業機器、その他	62	60	-2	-3.2%
電子回路基板		427	602	175	41.0%
	EMS	61	54	-7	-11.5%
	ODM	43	61	18	41.9%
	コンポーネント		15	15	-
電子機器		104	130	26	25.0%
合計		531	732	201	38.0%

2026年度第1四半期 製品別実績

(単位：億円)

		2025年度	2026年度	前年同期比	
		第1四半期実績	第1四半期実績	増減額	増減率
	4層板以下	102	129	27	26.5%
	16層板以下	84	102	18	21.4%
	多層貫通基板	186	231	45	24.2%
	8層板以下	114	210	96	84.2%
	16層板以下	113	145	32	28.3%
	高多層				
	ビルドアップ基板	227	355	128	56.4%
	半導体PKG基板	4	4	0	0.0%
	リジッドフレキ、フレキ、 放熱、大電流、その他	10	12	2	20.0%
	電子回路基板	427	602	175	41.0%
	EMS	61	54	-7	-11.5%
	ODM	43	61	18	41.9%
	コンポーネント		15	15	-
	電子機器	104	130	26	25.0%
合計		531	732	201	38.0%

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。